

证券代码：600460

证券简称：士兰微

编号：临 2022-063

杭州士兰微电子股份有限公司

关于控股子公司投资建设项目的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、投资概述

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“士兰微”）于 2022 年 6 月 13 日召开的第七届董事会第三十五次会议和 2022 年 6 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于成都士兰投资建设项目的议案》：公司拟通过控股子公司成都士兰半导体制造有限公司（以下简称“成都士兰”）投资建设“年产 720 万块汽车级功率模块封装项目”，项目总投资为 30 亿元。

上述事项详见公司于 2022 年 6 月 14 日和 2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告，公告编号为临 2022-039 号和临 2022-040 号。

二、投资进展情况

成都士兰“汽车半导体封装项目（一期）”（原项目名称为“年产 720 万块汽车级功率模块封装项目”）已于 2022 年 10 月 2 日在金堂县发展和改革局完成备案，备案号：川投资备【2210-510121-04-01-381195】FGQB-0490 号。

后续公司将根据项目进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日